

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-34

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	易方达基金、南方基金、大成基金、长城基金、国投瑞银、摩根士丹利、博时基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、前海开源基金、信达澳亚基金、长城基金、宝盈基金、普来仕国际、上海混沌集团、长盛基金、上海高毅资产、中信证券、红塔红土基金、敦和资产、安信基金、富荣基金、红土创新基金、创金合信基金、WT CAPITAL、PinPoint Asset Mgmt、广发证券、平安证券、国寿养老
时间	2024年6月19日
地点	深南电路股份有限公司会议室；策略会举办地（海通证券策略会、财通证券策略会）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹 投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2024 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>2024 年一季度，公司 PCB 业务通信领域无线侧订单需求较去年第四季度未出现明显改善，有线侧交换机、光模块等需求有所增长。数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于 Eagle Stream 平台产品逐步起量，叠加 AI 加速卡等产品需求增长。汽车电子领域继续把握在新能源和 ADAS 方向的机会，延续往期需求。工控医疗等领域业务占比相对较小且需求相对保持平稳。</p> <p>Q2、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p>

Q3、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。

伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。

Q4、请介绍公司 PCB 业务汽车电子领域产品定位及主要客户类型。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司 PCB 业务汽车电子领域主要面向海外及国内 Tier1 客户，并参与整车厂部分研发项目合作。

Q5、请介绍公司 PCB 业务 HDI 工艺能力及相关产品布局情况。

HDI 作为一项平台型工艺技术，能够实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备包括 Any Layer（任意层互联）在内的 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q6、请介绍公司 PCB 各工厂是否区分不同下游领域安排生产。

公司在深圳、无锡、南通拥有多个 PCB 工厂。除部分专业工厂外，公司主要根据不同 PCB 产品的工艺要求特征来安排生产，产线本身对工艺相似的不同下游领域产品具有一定兼容性。

Q7、请介绍公司 2024 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

2024 年一季度，公司封装基板业务需求整体延续去年第四季度态势。BT 类封装基板保持稳定批量生产，FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

Q8、请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。

公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP 封装基板产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。

Q9、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

Q10、请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较一季度变化情况。

公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。

Q11、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生直接影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q12、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前已办理完成泰国子公司的备案登记事宜，并先后收

	<p>到国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》、国家商务部颁发的《企业境外投资证书》。签订土地购买协议，出资 2.89 亿泰铢购买约 70 莱的洛加纳工业园区内工业用地，并已筹备开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 19 日